

博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开2025年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2025-024

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年07月08日(星期二)11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可通过2025年07月01日(星期二)至07月07日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱mailto:bkencor@bekenor.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公司2024年年度及2025年第一季度报告,为使广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务状况、发展规划,公司于2025年07月08日(星期二)11:00-12:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络问答形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2025年07月08日(星期二)11:00-12:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长、总经理PENGFENG ZHANG先生,独立董事卢坤材先生,财务总监许瑞女士,董事会秘书李丽莉女士等相关人员。

四、投资者参与方式

(一)投资者可通过2025年07月08日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者提问。

(二)投资者可通过2025年07月01日(星期二)至07月07日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目,通过上证路演中心[questionCollection2](http://www.sse.com.cn/questionCollection2),根据说明会时间,点击本说明会或通过公司邮箱mailto:bkencor@bekenor.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会秘书办公室
联系电话:021-51008111-9890
联系地址:上海市浦东新区世纪大道1500号博通集成大厦10楼
联系邮箱:sib@bekenor.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2025-022

博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议召集人卢坤材先生,会议由卢坤材先生主持,应到监事3名,实到监事3名,公司董事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》有关规定。

二、监事会会议决议情况

本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期事项,符合相关法律法规的要求,相关调整符合公司实际情况发展情况,有利于提高募集资金使用效率,一致同意通过该议案,具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和《中国证券报》上刊登的《博通集成电路(上海)股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,0票回避。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司
监事会
2025年7月1日

博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议召集人卢坤材先生,会议由卢坤材先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》有关规定。

二、董事会会议决议情况

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》

经与会董事讨论并研究,公司本次部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期事项,符合相关法律法规的要求,相关调整符合公司实际情况发展情况,有利于提高募集资金使用效率,一致同意通过该议案,具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和《中国证券报》上刊登的《博通集成电路(上海)股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,0票回避。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司
董事会
2025年7月1日

博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议召集人卢坤材先生,会议由卢坤材先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》有关规定。

二、董事会会议决议情况

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》

经与会董事讨论并研究,公司本次部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期事项,符合相关法律法规的要求,相关调整符合公司实际情况发展情况,有利于提高募集资金使用效率,一致同意通过该议案,具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和《中国证券报》上刊登的《博通集成电路(上海)股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,0票回避。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司
董事会
2025年7月1日

博通集成电路（上海）股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目 变更、延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容:

- 拟变更项目名称:智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目
- 拟结项项目名称:研发中心建设项目
- 新项目名称:边缘AI处理单元产品及解决方案研发项目
- 原项目总投资额:1292万元
- 变更募集资金投向金额:31,845.54万元(以转入当日的实际金额为准),其中,拟调减“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”的募集资金投入金额21,042.13万元,用于投向本次新增募投项目“研发中心建设项目”;另变更募集资金10,803.41万元(实际金额以转出当日银行结息后的金额为准)用于投向本次新增募投项目,为规范募集资金管理,公司拟将本次项目结项后结余的募集资金转入2020年非公开发行股票项目对应的募集资金专户中进行管理。

●募集资金使用相关事项尚需提交股东大会审议

(一)2019年首次公开发行股票募集资金基本情况及项目结项情况

1.2019年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354号”《关于核准博通集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票34,678,380股,每股发行价格为人民币18.63元,共募集资金人民币646,068,293.92元;扣除发行费用、保荐费(含税)人民币38,533,206.17元后的募集资金为人民币607,535,087.75元,已由中国工商银行股份有限公司2019年4月24日按照缴款通知书分别存入公司设立的募集资金专户。扣除发行费用、保荐费(含税)及其他发行(不含税)的费用人民币748,580.37元,募集资金净额为603,966,507.38元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2019]第2A1156-4号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2.2019年首次公开发行股票募集资金使用情况

截至2025年6月20日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

序号	承诺投资项目	期初余额	期末余额	投入金额	投入比例
1	智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	70,398,691	71,067,381	66,678,691	94.73%
2	研发中心建设项目	11,381,382	11,613,182	10,281,382	90.28%
3	边缘AI处理单元产品及解决方案研发项目	6,711,182	6,787,182	6,787,182	100.00%
4	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
5	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
6	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
7	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
8	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
9	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
10	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
11	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
12	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
13	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
14	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
15	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
16	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
17	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
18	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
19	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
20	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
21	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
22	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
23	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
24	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
25	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
26	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
27	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
28	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
29	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
30	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
31	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
32	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
33	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
34	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
35	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
36	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
37	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
38	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
39	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
40	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
41	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
42	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
43	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
44	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
45	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
46	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
47	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
48	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
49	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
50	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
51	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
52	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
53	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
54	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
55	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
56	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
57	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
58	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
59	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
60	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
61	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
62	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
63	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
64	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
65	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
66	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
67	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
68	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
69	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
70	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
71	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
72	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
73	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
74	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
75	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
76	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
77	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
78	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
79	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
80	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
81	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
82	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
83	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
84	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
85	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
86	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
87	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
88	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
89	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
90	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
91	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
92	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
93	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
94	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
95	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
96	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
97	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
98	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
99	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%
100	研发中心建设项目	20,477,928	20,477,928	20,477,928	100.00%

截至2025年6月20日,公司首次公开发行股票募集资金实际剩余资金34,333.40万元(包含募集资金存储及现金管理专户利息收入累计计5,566.07万元)。

三、拟变更部分募集资金投资项目,在充分考虑公司战略重点方向及市场环境变化因素的基础上,公司拟调整“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”的投资总额和内部投资结构并调减其募集资金投资金额21,042.13万元,调减募集资金至全部募投项目“边缘AI处理单元产品及解决方案研发项目”,具体如下:

(一)2020年非公开发行股票募集资金基本情况及项目变更、延期情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2212号”《关于核准博通集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向非公开发行人民币普通股(A股)股票11,711,432股,每股发行价格为人民币7.61元,共募集资金人民币88,900,000元;扣除发行费用、保荐费(含税)人民币16,702,376.44元后的募集资金为人民币72,197,623.56元,已由中国工商银行股份有限公司2020年12月24日按照缴款通知书分别存入公司设立的募集资金专户。扣除发行费用、保荐费(含税)及其他发行(不含税)的费用人民币203,939.87元,募集资金净额为71,993,683.69元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第2A16102号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2.2020年非公开发行股票募集资金使用情况

截至2025年6月20日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

博通集成电路(上海)股份有限公司					
承诺投资项目					